

为新一代的移动出行带来变革！SEKISUI解决方案

Sekisui Mobility Solution



安全 (ADAS)



环境



设计/舒适

产品咨询

积水化学工业株式会社 高机能塑料事业领域 移动出行战略室



sekisui-auto@sekisui.com



间隙形成&粘合

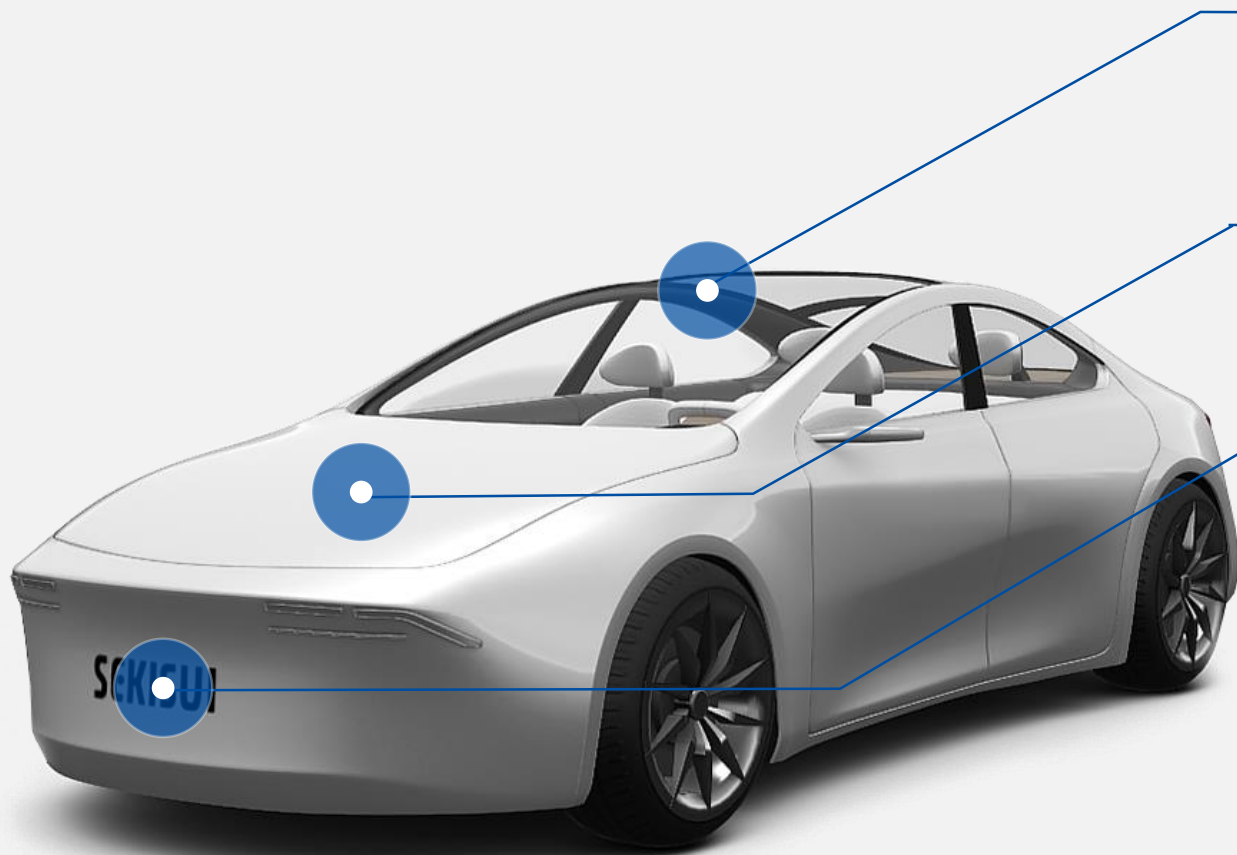
含有焊锡粒子的异方性导电胶 SACP

安全 (ADAS)

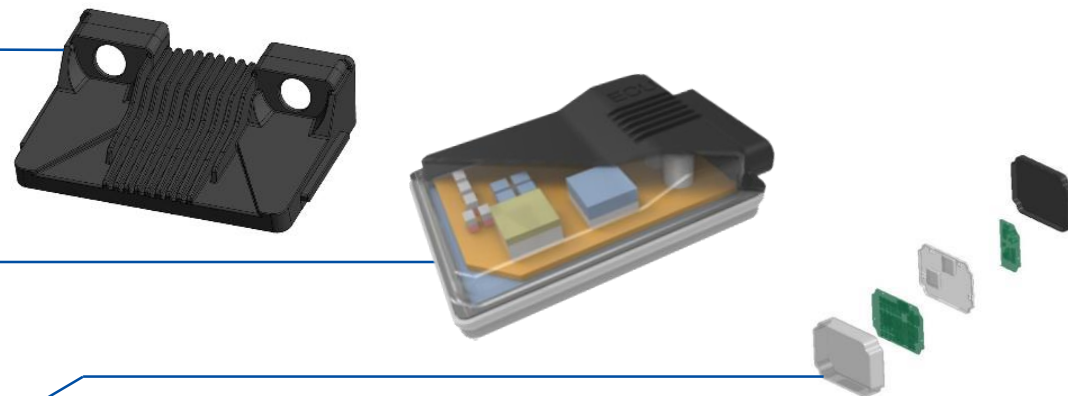
环境

设计/舒适

可在低温低压条件下使金属接合的异方性导电胶



用途示例：摄像头模块的连接，代替连接器



※示例图

产品



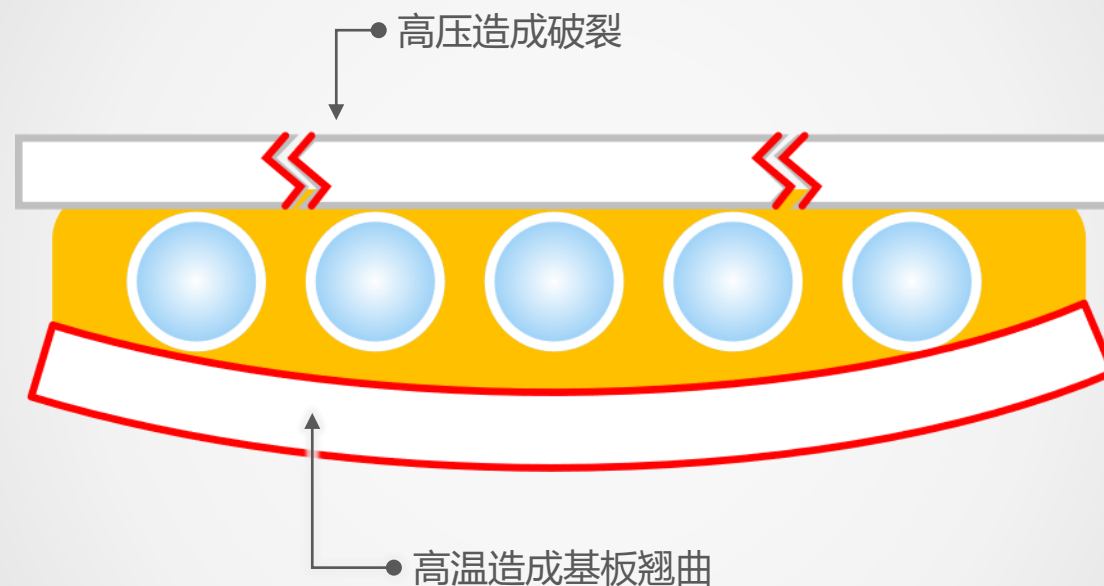


Challenge

因基板小型化、薄型化导致实装难度增大

随着封装、PCB的高性能化、小型化、薄型化的发展，实现高速化的低间隙化、确保高温高湿环境下的高可靠性等，对实装时的技术要求也越来越高。

另外，随着封装、PCB的薄型化，传统高温焊接工艺中因高温引起的基板翘曲问题更加显著。





Solution

低温、低压金属连接

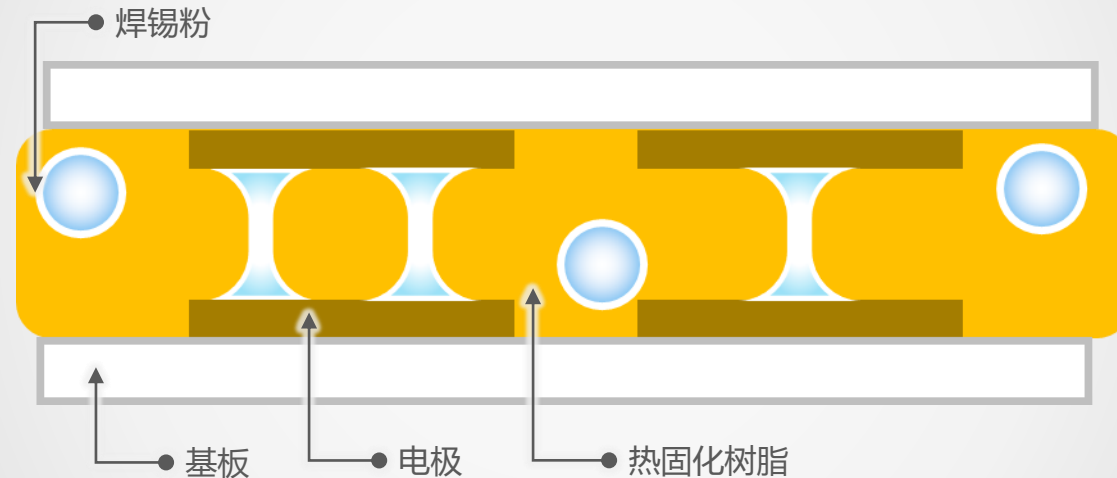
“含有焊锡粒子的异方性导电胶 SACP” 是可以在低温低压条件下进行金属连接的导电胶。

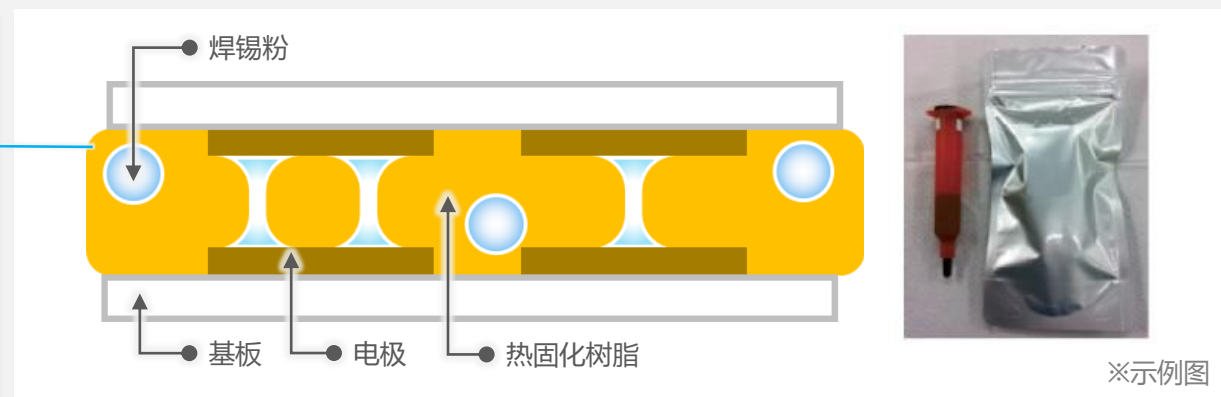
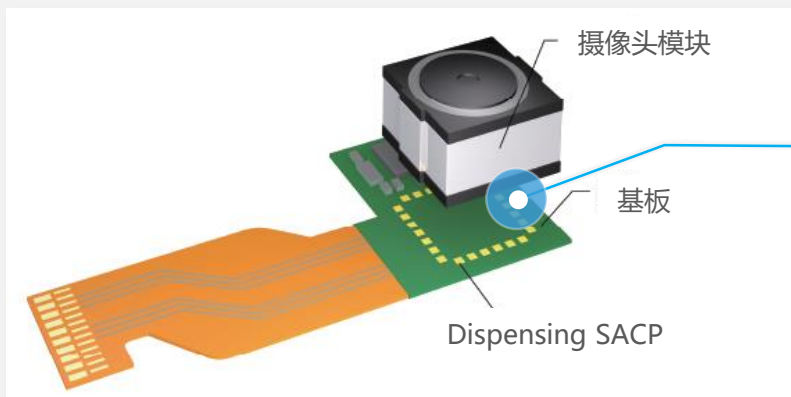
可使用低压、低温的键合工艺（约1MPa、140°C×10秒）实现金属连接。

即使在高温高湿的环境下也能保持高可靠性。

可进行低厚度连接（厚度0.1mm以下）和窄间距连接（150μm）。

支持低温工艺，使基板不翘曲、不开裂。



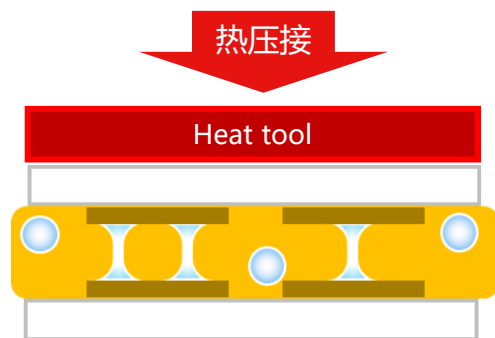


技术概述

feature

01 可低温低压实装

在压力1MPa 140度×10秒的
条件下可实装

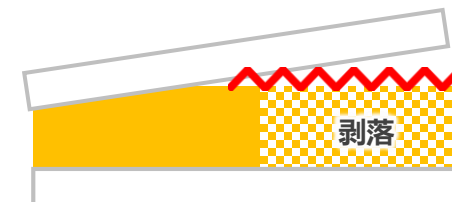


feature

02 高可靠性性能

即使在高温高湿环境下
也可保持高可靠性

- 保持高粘合力
- 保持低电阻





技术数据

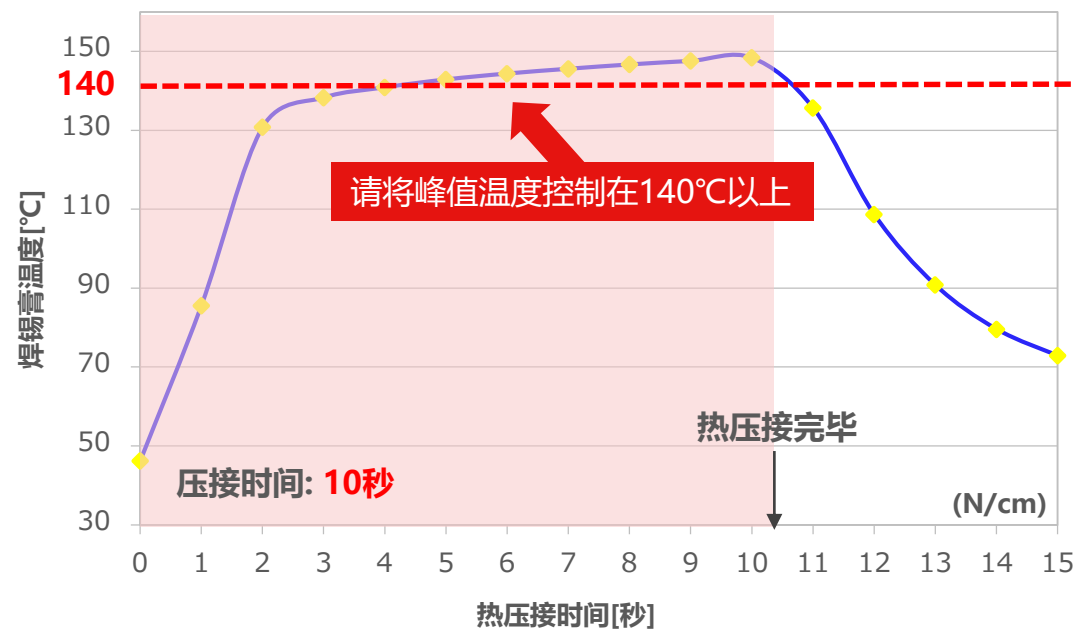
feature

01

可低温低压实装

推荐热压接条件

压力 1-3MPa
温度 峰值140℃以上
热压接时间 10秒以上

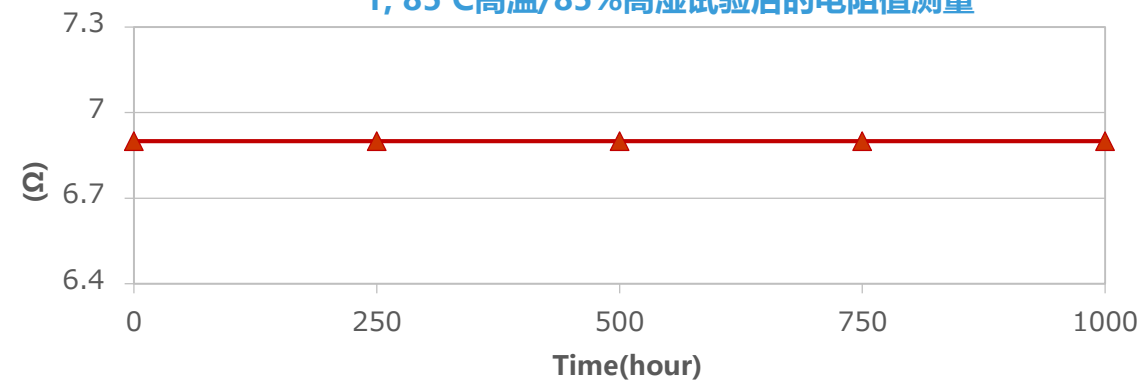


feature

02

高可靠性性能

1, 85℃高温/85%高湿试验后的电阻值测量



2, 85℃高温/85%高湿试验后的粘合力测量

